

The following is an English translation of claim 1 of JP
2002-178518 A.

[Claim 1] An ink jet printhead comprising:

a plurality of ink channels each having a pair of separation walls to be spaced from adjacent ink channels, and

an electrode arranged on internal surfaces of the pair of separation walls, in electrical connection to an external drive circuit for applying drive pulses to deform the pair of separation walls so that the ink in the ink channels is discharged,

wherein the ink channels are formed to have a constant cross-sectional shape throughout length thereof in an ink discharge direction, and

wherein the external drive circuit and the electrode are connected electrically through a conductive material arranged on an end, upstream in the ink discharge direction, of each of the ink channels.

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number : 2002-178518

(43)Date of publication of application : 26.06.2002

(51)Int.Cl.

B41J 2/045
B41J 2/055
B41J 2/16

(21)Application number : 2000-384365

(22)Date of filing : 18.12.2000

(71)Applicant : SHARP CORP

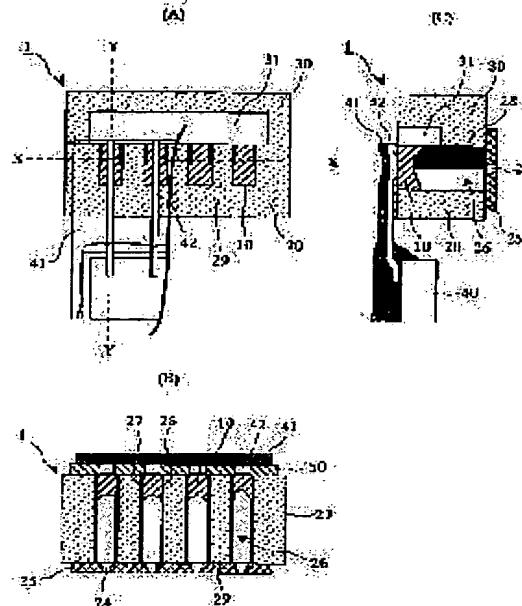
(72)Inventor : SAKAMOTO YASUHIRO
MATOBA KOJI
KAKIWAKI NARIMITSU
ISONO HITOSHI
NAKAJIMA YOSHINORI

(54) ELECTRODE CONNECTION STRUCTURE AND MANUFACTURING METHOD FOR INK JET HEAD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To prevent a substrate area from increasing without escalating costs caused by using an expensive manufacturing apparatus, complicating a manufacturing process, a yield decrease by an electrode disconnection, etc.

SOLUTION: In an ink jet head 1, a conductive resin 10 containing an Ag conductive filler is filled in a rear face 21 of each of a plurality of slit-like ink chamber 26 formed to an actuator (substrate) 20 comprising a PZT piezoelectric element. The conductive resin 10 is exposed to the rear face side of the ink chambers 26. Each ink chamber 26 formed between a pair of diaphragms 29 has a constant sectional shape over the whole length in a longitudinal direction of an ink discharge direction. In a state while being electrically connected with each other via the conductive resin 10, electrodes 27 and 28 opposite to each other in each ink chamber 26 are connected to an outer lead 42 of an IC for driving. Only an active region of the ink chamber 26 is formed to the actuator 20, thus eliminating the need of forming a region for electrode lead connecting the electrodes 27, 28 and the IC 40 for driving with each other.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開2002-178518

(P2002-178518A)

(43) 公開日 平成14年6月26日 (2002.6.26)

(51) Int.Cl.⁷

B 41 J 2/045
2/055
2/16

識別記号

F I

B 41 J 3/04

デマコード(参考)

103A 2C057
103H

審査請求 未請求 請求項の数13 O L (全 14 頁)

(21) 出願番号 特願2000-384365(P2000-384365)

(22) 出願日 平成12年12月18日 (2000.12.18)

(71) 出願人 000005049

シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

(72) 発明者 坂本 泰宏

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内

(72) 発明者 的場 宏次

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内

(74) 代理人 100084548

弁理士 小森 久夫

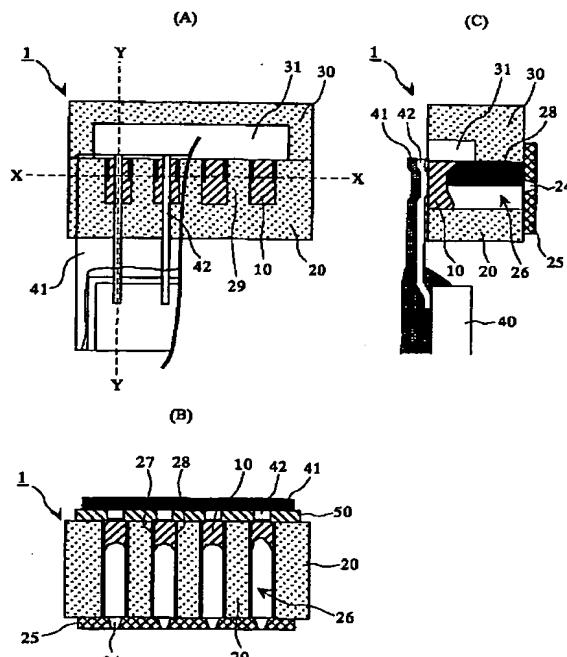
最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 インクジェットヘッドの電極接続構造及び製造方法

(57) 【要約】

【課題】高価な製造装置の使用、製造工程の複雑化及び電極の断線による歩留りの低下等に起因するコストの高騰を招くことなく、基板面積の増加を防止する。

【解決手段】インクジェットヘッド1は、P Z T圧電素子からなるアクチュエータ(基板)20に複数形成された溝状のインク室26のそれぞれの背面側21にAg導電性フィラーを含有する導電性樹脂10を充填し、インク室26の背面側に導電性樹脂10を露出している。一対の隔壁29の間に形成された各インク室26は、インク吐出方向である長手方向の全長にわたって一定の断面形状を呈しており、各インク室26内で互いに対向する電極27, 28は、導電性樹脂10を介して電気的に導通した状態で駆動用IC40のアウターリード42に接続する。アクチュエータ20には、インク室26のアクティブ領域のみが形成され、電極27, 28と駆動用IC40との接続のための電極引出しの領域を形成する必要がない。



【特許請求の範囲】

【請求項1】溝状のインク室を挟む一対の隔壁の各内側面に外部駆動回路に電気的に接続された電極を形成し、外部駆動回路からの電極に対する駆動パルスの印加により隔壁を変形させてインク室内のインクを吐出するインクジェットヘッドにおいて、

インク室内をインク吐出方向の全域にわたって同一断面形状に形成し、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部に配置した導電性材料を介して外部駆動回路と電極とを電気的に接続することを特徴とするインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項2】前記導電性材料は、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一対の隔壁間に閉塞する導電性樹脂であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項3】前記導電性材料は、所定材料からなる所定形状の導電性フィラーを含むことを特徴とする請求項2に記載のインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項4】前記導電性材料は、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一対の隔壁に形成された電極間に閉塞する半田であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項5】前記導電性材料は、インク室から露出した部分で外部駆動回路の接続端子が電気的に接続されることを特徴とする請求項2又は3に記載のインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項6】前記導電性材料は、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部に挿入される外部駆動回路の接続端子であることを特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項7】前記導電性材料は、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一対の隔壁に形成された電極間に閉塞する導電性樹脂と、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部に挿入される外部駆動回路の接続端子と、からなることを特徴とする請求項1に記載のインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項8】前記電極間に閉塞する導電性材料は、異方導電性接着剤であることを特徴とする請求項7に記載のインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項9】前記電極又は導電性材料のいずれか一方は、インク室の上流側端部に対する導電性材料の挿入時における残る他方との当接によって変形を生じることを特徴とする請求項6乃至8のいずれかに記載のインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項10】前記インク室の上流側端部に、導電性材料をインク室内に導く形状のガイド部を形成したことを特徴とする請求項6乃至9のいずれかに記載のインクジェットヘッドの電極接続構造。

【請求項11】厚さ方向に分極処理された圧電体のチャンネルウェハの上面に所定ピッチで複数の溝を形成する

工程と、各溝の対向面に互いに独立した電極を形成する工程と、各溝の単一又は複数の位置において対向面の電極間に閉塞する所定幅の導電性材料を挿入する工程と、チャンネルウェハの上面にカバーウェハを接着する工程と、各溝内の導電性材料を切断する位置でチャンネルウェハ及びカバーウェハを分割する工程と、を含むことを特徴とするインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項12】前記導電性材料を挿入する工程は、導電性材料である半田を光エネルギによって溶融する工程を含むことを特徴とする請求項11に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【請求項13】前記導電性材料を挿入する工程は、チャンネルウェハにおける導電性材料が挿入されない部分を冷却する工程を含むことを特徴とする請求項11又は12に記載のインクジェットヘッドの製造方法。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】この発明は、インク室内のインクを加圧して記録媒体上に吐出することによって画像形成を行なうインクジェットヘッドの電極と外部駆動回路とを接続するための電極接続構造、及び、インクジェットヘッドの製造方法に関する。

【0002】

【従来の技術】インクジェットプリンタに用いられるインクジェットヘッドとして、溝状のインク室を挟む一対の隔壁の各内側面に電極を形成し、外部駆動回路からの電極に対する駆動パルスの印加により隔壁を変形させてインク室内のインクを吐出するようにしたものがある。このようなインクジェットヘッドにおいては、インク室内に形成された電極をインク室外に延出して取り出し用の室外電極を形成し、この室外電極と駆動用ICを含む外部駆動回路とを電気的に接続するようしている。従来のインクジェットヘッドにおける室外電極と外部駆動回路との接続方法として、図6～図8に示すように、ボンディングワイヤを用いる方法、TAB(Tape Automated Bonding)リードを用いる方法、及び、フレキシブル基板を用いる方法が知られている。

【0003】即ち、駆動用IC130とともに支持体110上に配置されるアクチュエータ100は、図面に垂直な方向に配列する複数の隔壁127のそれぞれの間にインク室122を形成した圧電素子からなる基板103と、各インク室122にインクを供給する供給口124を形成して基板103の上面に配置されるカバーブレート123と、各インク室122内からインクが吐出されるノズル126を形成して基板103の前面に配置されるノズルブレート125と、から構成され、各インク室122において隔壁126の上側の略半分の範囲に電極101が形成されている。この電極101は、基板103の上面における背面側に延出して形成されており、この延出した部分が取り出し用の室外電極102にされて

いる。

【0004】ポンディングワイヤを用いる方法では、図6に示すように、アクチュエータ100の室外電極102と駆動用IC130の接続ポイントとの間を、A1ウェッジワイヤポンディング技術やAuワイヤポンディング技術により、平坦面である室外電極102の上面及び駆動用IC130の接続ポイントに対して上方からポンディングキャビラリを介してポンディングワイヤ111を押圧した状態で加熱超音波を印加することによって金属の固相拡散接合を行う。

【0005】TABリードを用いる方法では、図7に示すように、TABデバイスのアウタリード112をアクチュエータ100の室外電極102と平行に位置決めした状態で上方から加熱加圧機構を有するリード押圧具を押圧し、アウタリード112の下面に予めメッキされている半田を溶融させて半田接合を行う。半田に代えて、ACF（異方性導電フィルム）又はACP（異方性導電ペースト）を用いる場合もある。

【0006】フレキシブル基板を用いる方法では、図8に示すように、駆動用IC130を実装したプリント基板114上に形成された接続用電極115及びアクチュエータ100の室外電極102の上面にフレキシブル基板113の両端部を載置し、図7に示したTABリードを用いる場合と同様に、半田接合やACF又はACPによる接合が行われる。

【0007】次に、インクジェットヘッドを構成するアクチュエータの従来の製造方法を図9を用いて説明する。先ず、厚さ方向（上下方向）に分極した圧電素子からなる基板103の上面103aにドライフィルムレジストをラミネートして硬化させた後、ダイサーのダイシングブレードを用いて上面103aを前面103b側から背面103c側に向かってハーフダイシングし、隔壁127の間に挟まれたインク室122を形成する。このとき、基板103の前面103bと背面103cの中間部でダイシングブレードを上昇させてインク室122の背面側にアール部122aを形成し、さらに、背面103cまで上面103aのドライフィルムレジストのみをカットして平坦部122bを形成する。

【0008】このダイシング処理を基板103の前面103b及び背面103cに平行な方向に繰り返し実行し、基板103上にインク室アレイを形成した後に、インク室122の長手方向に対して基板103の上方からA1又はCu等の電極材料となる金属を斜方蒸着する。この作業をインク室122を挟んで対向する2方向（図中矢印で示す方向）から行うことにより、インク室122を挟む両側の隔壁127に電極101を形成する。

【0009】このとき、インク室122内では、ドライフィルムレジスト及び隔壁126のシャドーニング効果により、隔壁127の上端から厚さ方向の約1/2までの範囲に電極101が形成される。また、インク室122

2のアール部122a及び平坦部122bにも同時に電極材料の斜方蒸着が行われるが、左右2方向から蒸着された金属膜が平坦部122bで重なり合うようにドライフィルムレジストの厚さ及び開口幅を設定することにより、平坦部122bにおいては開口部分の全面に電極（室外電極102）が形成され、アール部122aにおいてはインク室122内の電極101と平坦部122bの室外電極102とを接続する状態に電極が形成される。

10 【0010】この後、基板103の上面103aに供給口124を有するカバーブレート123を接着し、基板103の前面103bにノズル126を有するノズルブレート125を接着することにより、アクチュエータ100が完成する。

【0011】このようにして形成されたアクチュエータ100は、隣接するインク室122内に形成された電極101のそれぞれに、互いに逆位相の電位を印加することによりシェアモード駆動を行う。即ち、両側面のそれぞれに互いに逆極性の電位が印加された隔壁127は電極101の形成領域と未形成領域との境目で“く”の字に剪断変形を生じる。この隔壁127の剪断変形によるインク室122の体積変化、及び、これに伴うインク室122内のインク圧力の変化を利用してインク室122の前面103b側に配置したノズル126からインク液滴が吐出される。

【0012】

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、上記のように構成された従来のインクジェットヘッドでは、アクチュエータに形成されたインク室においてインクの吐出に直接寄与するアクティブ領域は供給口よりも前面側の範囲のみであり、供給孔を含む背面側はインク室内にインクを供給するためのみに使用され、アール部及び平坦部はインク室内において対向する電極の接続、及び、室外電極を介してインク室内の電極を外部駆動回路に接続するためのみに使用されている。このため、アクチュエータにおいて本来の機能であるインクの吐出に直接寄与しない領域が占める範囲が大きく、基板面積が増加して材料コストが高騰する問題がある。

【0013】また、誘電率の高いPZT等の圧電素子を素材とする基板上で平坦部までインク室内の電極を延出させるために基板の静電容量が大きくなり、アクチュエータの駆動に際して印加すべき駆動電圧波形が鈍り、高速印字を実現するための高速駆動を実現することができない問題がある。この問題は駆動電圧を高くするとアクチュエータにおける発熱量が増加し、アクチュエータの温度上昇によってインクの粘度が変化するため、高精度で安定した印字を行うことができなくなるとともに、容量の大きな駆動用ICが要求されることによる部品コストの高騰、及び、消費電力の増加によるランニングコストの高騰を招

く。

【0014】そこで、アクチュエータのインク室に形成された電極におけるアクティブ領域以外の部分では圧電素子と電極との間に低誘電膜を予め成膜しておくことにより、アクティブ領域以外の部分における基板の静電容量を殆ど無視できるレベルにすることも考えられる。しかし、キューリ点が200°C程度の低温度であるPZTに対して低温度のプロセスで低誘電率のSi-N膜を形成するためには高価なECR-CVD (Electron Cyclotron Resonance Chemical Vapor Deposition) 装置が必要となり、製造コストが高騰する問題がある。

【0015】また、特開平9-94954号公報には、図10に示すように、供給口及び電極を延出させるための領域を圧電素子の長手方向に形成しないようにした構成が開示されている。この構成では、インク室214に対するインクの供給は基板210のアクティブ領域の後端部に設けた供給口から行い、インク室214に形成された電極213を供給口側側面又は吐出口側側面に延出させ、駆動用IC216に導通した電極217と電気的に接続するようしている。

【0016】この構成によれば、アクチュエータにアクティブ領域以外の部分が存在しないために圧電素子の材料コストを低廉化することはできるが、基板の静電容量が増加する問題が残る。また、インク室内の電極をアクチュエータの側面に90°屈曲させて室外電極を延出するようしているため、ウェハ状態ではインク室内に電極を形成する際の斜方蒸着によって同時に室外電極を形成することはできない。

【0017】このため、ウェハから個々のアクチュエータを切り出した後にインク室内の電極とアクチュエータ側面の室外電極とを形成することになるが、インク室内の2つの電極を確実に電気的に導通させた状態で延出させるためには、少なくともさらに二方向からの斜方蒸着が必要となる。また、アクチュエータの側面に延出した室外電極を各インク室毎に分離するためには、予めバーニングを施すか、又は、ダイシングやYAGレーザによる電極分離工程が必要となる。このように、製造工程が複雑化するため、生産性の低下によるコストの高騰を招く。この室外電極はめっきによっても形成することができるが、蒸着による場合と同様にバーニング工程又は電極分離工程が必要となる。

【0018】また、形成された電極においてインク室からアクチュエータ側面に屈曲した部分が後の工程や運搬時等において断線する可能性が高く、歩留りの低下による生産コストの高騰を招く。

【0019】この発明の目的は、高価な製造装置の使用、製造工程の複雑化、及び、電極の断線による歩留りの低下等に起因するコストの高騰を招くことなく、基板面積の増加を防止することができ、材料コストの高騰を防止することができるとともに、基板の静電容量の増加

を防止してアクチュエータにおける発熱量の増加を伴うことなく高精度で安定した高速印字を行うことができるインクジェットヘッドの電極接続構造及び製造方法を提供することにある。

【0020】

【課題を解決するための手段】この発明は、上記の課題を解決するための手段として、以下の構成を備えている。

【0021】(1) 溝状のインク室を挟む一対の隔壁の各内側面に外部駆動回路に電気的に接続された電極を形成し、外部駆動回路からの電極に対する駆動バルスの印加により隔壁を変形させてインク室内のインクを吐出するインクジェットヘッドにおいて、インク室内をインク吐出方向の全域にわたって同一断面形状に形成し、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部に配置した導電性材料を介して外部駆動回路と電極とを電気的に接続することを特徴とする。

【0022】この構成においては、インク吐出方向の全域にわたって同一断面形状に形成したインク室の上流側端部に導電性材料を配置し、この導電性材料を介してインク室内の電極が外部駆動回路に電気的に接続される。したがって、インク室内の電極が導電性材料を介してインク室内において外部駆動回路に電気的に接続されるため、インク室内の電極をインク室内の電極をインク室外に引き出して構成する必要がないとともに、インク室内にインクの吐出に使用されるアクティブ領域以外の電極の引出しのためのスペースを設ける必要がなく、圧電素子の材料コストが削減されるとともに基板の静電容量の増加を生じることがない。

【0023】(2) 前記導電性材料は、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一対の隔壁間を閉塞する導電性樹脂であることを特徴とする。

【0024】この構成においては、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部が導電性樹脂によって閉塞される。したがって、導電性樹脂によってインク室のインク吐出方向における上流側端部からのインクの漏出が防止され、インク室内における殆どの範囲がインク吐出のためのアクティブ領域にされる。これによって、インク室を構成する圧電素子の材料コストが削減されるとともに基板の静電容量の増加を生じることがない。

【0025】(3) 前記導電性樹脂は、所定材料からなる所定形状の導電性フィラーを含むことを特徴とする。

【0026】この構成においては、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一対の隔壁間が所定材料からなる所定形状の導電性フィラーを含んだ導電性材料によって閉塞される。したがって、駆動周波数の向上又はコストの削減のいずれを重視するかに応じて材料を選択するとともに、電極の酸化皮膜の効率的な破壊又は単位体積当たりの接触面積の増加のいずれによって接続抵抗を低減するかに応じて形状を選択した導電性フィラ

ーを含む導電性樹脂を用いて、使用目的に応じた機能を実現する状態でインク室内の電極と外部駆動回路とが接続される。

【0027】(4)(3)の構成において、導電性フィラーの材料として、Au又はAgを用いることができる。

【0028】この構成によれば、インク室内の電極と外部駆動回路との接続抵抗を低く抑えることができ、アクチュエータを駆動するための駆動電圧の波形が鈍ることがなく、駆動周波数を高くして高速印字に対応することができる。

【0029】(5)(3)の構成において、導電性フィラーの材料として、Ni、Cu又はカーボンを用いることができる。

【0030】この構成によれば、比較的安価な材料によって導電性樹脂を構成することができ、コストの削減を図ることができる。

【0031】(6)(3)の構成において、導電性フィラーの形状として、外周部に鋭角部を有する形状とすることができます。

【0032】この構成によれば、導電性樹脂を一对の隔壁間に充填する際に、導電性フィラーとの接触によって電極表面の酸化皮膜を効果的に破壊することができ、電極と外部駆動回路との間の接続抵抗を低減することができる。

【0033】(7)(3)の構成において、導電性フィラーの形状として、略球形とすることができます。

【0034】この構成によれば、導電性樹脂内における導電性フィラーの密度を最も高くすることができ、導電性樹脂の単位体積当りの接触面積を増加して電極と外部駆動回路との間の接続抵抗を低減することができる。

【0035】(8)(3)の構成において、導電性フィラーの最大径を、インク室における一对の隔壁の間隔以下とすることができます。

【0036】この構成によれば、導電性フィラーを含む導電性樹脂を一对の隔壁間に確実に充填することができる。

【0037】(9)(3)の構成において、樹脂材料のガラス転移点を60°C以上とすることができます。

【0038】この構成によれば、インクジェットヘッドの保管温度領域及び使用温度領域において十分な信頼性を得ることができます。

【0039】(10)前記導電性材料は、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一对の隔壁に形成された電極間を閉塞する半田であることを特徴とする。

【0040】この構成においては、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一对の隔壁間が半田によって閉塞される。したがって、電極と外部駆動回路とを電気的に接続する際の接続部分に十分な強度が与えられ、接続状態の信頼性が向上する。

【0041】(11)(10)の構成において、半田を、Sn基

半田とすることができます。

【0042】この構成によれば、比較的安価かつ入手容易な半田を用いて電極と外部駆動回路とを電気的に接続することができ、コストを削減することができる。また、添加量元素や添加量の変更が容易で、電極と外部駆動回路との接続工程時における温度条件に応じて溶融温度を容易に調整することができ、製造工程や仕様の変化に簡単に対応することができる。

【0043】(12)(10)の構成において、半田の融点を80°C以上とすることができます。

【0044】この構成によれば、インクジェットヘッドの保管温度領域及び使用温度領域において十分な信頼性を得ることができます。

【0045】(13)前記導電性材料は、インク室から露出した部分で外部駆動回路の接続端子が電気的に接続されることを特徴とする。

【0046】この構成においては、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一对の隔壁間を閉塞する導電性材料のインク室から露出した部分に外部駆動回路の接続端子が電気的に接続される。したがって、インク室が形成されている基板に外部駆動回路の接続端子が直接接触することができなく、電極と外部駆動回路との接続部分が電極に対する駆動電圧の印加による隔壁の変形の影響を受けることがない。

【0047】(14)前記導電性材料は、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部に挿入される外部駆動回路の接続端子であることを特徴とする。

【0048】この構成においては、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部に外部駆動回路の接続端子を挿入することにより、インク室内の電極と外部駆動回路とが電気的に接続される。したがって、インク室内の電極と外部駆動回路とが容易に電気的に接続される。

【0049】(15)前記導電性材料は、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一对の隔壁に形成された電極間を閉塞する導電性樹脂と、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部に挿入される外部駆動回路の接続端子と、からなることを特徴とする。

【0050】この構成においては、導電性樹脂が充填されたインク室の上流側端部に外部駆動回路の接続端子が挿入される。したがって、インク室内の電極は導電性樹脂と接続端子との接続によって外部駆動回路に電気的に接続される。

【0051】(16)前記電極間を閉塞する導電性樹脂は、導電性接着剤であることを特徴とする。

【0052】この構成においては、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部においてインク室内の電極と外部駆動回路の接続端子とが導電性接着剤を介して電気的に接続される。したがって、外部駆動回路の接続端子はインク室の隔壁に直接当接することなくインク室の上流側端部に挿入され、隔壁を破損することができない。ま

た、インク室の上流側端部に対する外部駆動回路の接続端子の挿入時の衝撃が導電性接着剤によって緩衝され、振動による歪を生じることがない。

【0053】(17)(16)の構成において、導電性接着剤を異方導電性接着剤とすることができる。

【0054】この構成によれば、インク室の隔壁を含むインク吐出方向における基板の上流側の側面に異方導電性接着剤を塗布することにより、インク室内の電極と外部駆動回路の接続端子との電気的接続と同時に、基板と外部駆動回路との機械的接合を行うことができる。

【0055】(18)前記外部駆動回路の接続端子は、インク室の上流側端部への挿入時に導電性樹脂との当接によって変形を生じることを特徴とする。

【0056】この構成においては、インク室の上流側端部に外部駆動回路の接続端子を挿入した際に、導電性樹脂との当接によって外部駆動回路の接続端子に変形を生じる。したがって、インク室の上流側端部に外部駆動回路の接続端子を挿入する際の衝撃が接続端子によって緩衝され、隔壁の破損や振動による歪を生じることがない。

【0057】(19)前記インク室の上流側端部に、外部駆動回路の接続端子をインク室を構成する一対の隔壁間に導く形状のガイド部を形成したことを特徴とする。

【0058】この構成においては、インク室の上流側端部への挿入時に外部駆動回路の接続端子がガイド部によってインク室を構成する一対の隔壁間に導かれる。したがって、外部駆動回路の接続端子がインク室内に確実に挿入される。

【0059】(20)(19)の構成において、ガイド部は、インク吐出方向における基板の上流側側面においてインク室の周縁部から内部に向かって開口径が縮小する傾斜面とすることができる。

【0060】この構成によれば、外部駆動回路の接続端子を傾斜面に当接させることにより、傾斜面に沿って外部駆動回路の接続端子をインク室内に導くことができ、外部駆動回路の接続端子をインク室内に挿入する作業を簡略化できる。

【0061】(21)厚さ方向に分極処理された圧電体のチャンネルウェハの上面に所定ピッチでそれそれが一対の隔壁に挟まれた複数の溝を形成する工程と、各溝における一対の隔壁の対向面に互いに独立した電極を形成する工程と、各溝の單一又は複数の位置において一対の隔壁間を閉塞する導電性材料を挿入する工程と、チャンネルウェハの上面にカバーウェハを接着する工程と、各溝内の導電性材料を切断する位置でチャンネルウェハ及びカバーウェハを分割する工程と、を含むことを特徴とする。

【0062】この構成により、チャンネルウェハ上に、それそれが互いに独立した電極を有する一対の隔壁に挟まれた溝状を呈するとともに、インク吐出方向における

上流側端部が導電性材料によって閉塞され、さらに、上面がカバープレートで被覆された複数のインク室を所定ピッチで配列したインクジェットヘッドが形成される。したがって、インク吐出方向においてインク室の電極と外部駆動回路とを電気的に接続するための領域が不要になり、チャンネルウェハ上における各インクジェットヘッドの面積が削減される。

【0063】(22)前記導電性材料を挿入する工程は、導電性材料である半田ベーストを光エネルギーによって溶融する工程を含むことを特徴とする。

【0064】この構成においては、光エネルギーによる局部加熱によって溶融した半田ベーストを用いてインク吐出方向におけるインク室の上流側端部が閉塞される。したがって、インク室のアクティブ領域に過大な熱負荷が作用することによる脱分極を生じることがなく、インク吐出性能が低下することがない。

【0065】(23)前記導電性材料を挿入する工程は、チャンネルウェハにおける導電性材料が挿入されない部分を冷却する工程を含むことを特徴とする。

【0066】(24)この構成においては、インク吐出方向におけるインク室の上流側端部を導電性材料によって閉塞する間にインク室のアクティブ領域となる部分が強制的に冷却される。したがって、インク室のアクティブ領域に熱負荷が作用せず、脱分極によるインク吐出性能の低下が確実に防止される。

【0067】

【発明の実施の形態】図1(A)～(C)は、この発明の第1の実施形態に係る電極接続構造を適用したインクジェットヘッドの要部の構成を示すインク吐出方向の背面断面図、平面断面図((A)図におけるX-X部断面図)及び側面断面図((A)図におけるY-Y部断面図)である。この実施形態に係るインクジェットヘッド1は、PZT圧電素子からなるアクチュエータ(基板)20に複数形成された溝状のインク室26のそれぞれの背面部21にAg導電性フィラーを含有する導電性樹脂10が充填されており、インク室26の背面側に導電性樹脂10が露出している。

【0068】一対の隔壁29の間に形成された各インク室26は、インク吐出方向である長手方向の全長にわたって一定の断面形状を呈しており、互いに対向する隔壁29の側面の上側半分に電極27、28が形成されている。互いに対向する電極27、28は、導電性樹脂10を介して電気的に導通した状態で駆動用IC40のアウトーリード42に接続されている。アクチュエータ20の前面には各インク室26に対応するノズル孔24を形成したノズルプレート25が貼付されており、アクチュエータ20の上面にはインク室26の上部にインク供給部31を形成するカバープレート30が貼付されている。

【0069】このようにして、アクチュエータ20にア

レイ状に形成されたインク室26が有する電極27, 28に導電性樹脂10及びアウターリード42を介して駆動用IC40から同電位の駆動電圧を印加するとともに、隣接するインク室26において隔壁29を挟んで対向する電極28, 27に逆位相の電圧を印加することにより、隔壁29を剪断変形させてインク室26内のインク圧力を制御し、インク室26内のインクをノズル孔24から前面側に吐出させる。

【0070】導電性樹脂10と駆動用IC40との電気的接続は、各インク室26に対応したアウターリード42を独立して保持するTABテープ41を介して行われる。このとき、アクチュエータ20の背面とTABテープ41との間の隙間にACF(Anisotropic Conductive Film:異方導電性フィルム)50を介在させることにより、導電性樹脂10とアウターリード42との電気的接続に機械的に十分な強度を与えることができる。

【0071】なお、アウターリード42の表面にAuメッキバンプ、Au転写バンプ又はAuボールバンプを形成し、このバンプを導電性樹脂10に突き刺して導通させるようにしてもよい。これによって、導電性樹脂10とアウターリード42との接触面積を大きくし、安定した電気的接続状態を得ることができる。

【0072】また、駆動用IC40に形成された接続端子を直接、導電性樹脂10に接続することもでき、この場合に、接続端子を導電性樹脂10に突き刺すこともできる。これによって、駆動用IC40を構成するペアチップがアクチュエータ20に実装されることになり、インクジェットヘッド1の小型化及び軽量化が図れるとともに、駆動用IC40において発生した熱がインクを含むアクチュエータ20に伝導することによって駆動用IC40を冷却することができる。

【0073】図2は、上記インクジェットヘッドの製造方法の要部を説明する図である。図1に示したインクジェットヘッド1を製造する際には、先ず、厚さ方向に分極した圧電素子からなるチャンネルウェハ60の表面にドライフィルムレジスト70をラミネートして硬化させる。次いで、ダイサーのダイシングブレードを用いてチャンネルウェハ60を一定ピッチでハーフダイスすることにより、図2(A)に示すように、インク室26となる複数の溝部を形成する。このとき、ダンシングブレードのダイシング幅は、後に充填される導電性樹脂10が含有する導電性フィラー径よりも大きくすべきであり、直径0.1μm～70μmの導電性フィラーを含有した導電性樹脂10を用いる場合にはダンシング幅は70μm以上とする。

【0074】この後、チャンネルウェハ60の斜め上方の両側から各溝部の長手方向に直交する方向にA1又はCu等の電極材料となる金属を蒸着し、ドライフィルムレジスト70をリフトオフする。これによって、ドライフィルムレジスト70及び各溝部間に位置する隔壁29

のシャドーイング効果により、各溝部において互いに対向する2側面の上側半分のみに、各溝部間で電気的に分離された状態で電極27, 28が形成される。

【0075】次に、チャンネルウェハ60の上面から溝部の長手方向に直交する方向に、一例として0.5mm幅で液状(未硬化)の導電性樹脂10をディスペンサー等を用いて塗布し、溝部の内部及び隔壁29の上面に付着させる。さらに、図2(B)に示すように、ラバースキージを用いてインク室26の上面に付着した導電性樹脂10を溝部内に充填しつつ除去した後、加熱等によって導電性樹脂10を硬化させる。

【0076】なお、各溝部間の電気的な分離のために溝部の内部にのみ導電性樹脂10を供給すべきであり、溝部の形成ピッチが200μm程度であれば精密ノズルを用いて実現できる。

【0077】また、導電性樹脂10の加熱時におけるアクチュエータの熱負荷による影響を考慮して、チャンネルウェハ60においてインク室26のアクティブ領域となる部分を冷却するか、又は、室温放置によって導電性樹脂10を硬化させるようにしてもよい。

【0078】次いで、チャンネルウェハ60の上面に、インク供給部31をザグリによって形成したカバーウェハ61を接着剤を介して貼付する。このカバーウェハ61は、インクジェットヘッド1においてカバーブレート30を構成する。通常、カバーウェハ61の素材は、インク室26を構成するアクチュエータとの熱膨張率のマッチングを良くするために、インク室26が形成されるチャンネルウェハと同一の素材である圧電素子が用いられるが、コスト削減のためにアルミニナセラミックを用いる場合もある。この時、図2(C)に示すように、チャンネルウェハ60において導電性樹脂10が充填された部分が、カバーウェハ61に形成されたインク供給部31の中央部に對向するように位置決めする。

【0079】この後、図2(C)中破線で示す位置においてダイシングブレードによるダイシングを行い、個々のアクチュエータに分割する。各アクチュエータの一方の切断面には、インク吐出方向におけるインク室26上流側端部を閉塞する導電性樹脂10が露出しており、この導電性樹脂10に駆動用IC40の接続端子を電気的に接続してアクチュエータが完成する。

【0080】なお、導電性樹脂10に代えて、インク室26を構成する各溝部の所定の位置に半田を充填することができる。半田を用いた場合には、導電性樹脂10を用いた場合に比較して駆動用IC40に導通した電極との機械的な接続状態及び電気伝導率に優れ、より信頼性の高い接続状態を得ることができるとともに、各インク室26間における電気抵抗のバラツキも少ない。この場合には、フラックスと半田微粒子とを混練した半田ペーストをディスペンサー等によって供給し、レーザ光の照射による局所加熱によって半田を一旦溶融させた後に凝固

させことにより、アクチュエータのアクティブ領域となる部分への熱負荷を軽減することができるが、チャンネルウェハ60におけるアクティブ領域となる部分を強制冷却することにより、熱負荷によるアクティブ領域における脱分極をより確実に防止することもできる。

【0081】上記のように、この実施形態に係る電極接続構造を用いたインクジェットヘッド1では、外部駆動回路である駆動用IC40との電気的接続用の電極がインク吐出方向におけるインク室26内の上流側端部に充填された導電性樹脂10によって形成される。したがって、従来のようにインク室内の電極を外部に引き出すための構成が不要になり、アクチュエータ20のインク吐出方向にはインク室26のアクティブ領域以外の部分が殆ど必要とされず、材料コストが削減される。また、アクチュエータ20の体積が減少することによって静電容量が低減され、電極を駆動するために印加される信号の周波数を高くすることができ、高速印字に適応することができる。また、同一の周波数では駆動電圧を低減するためにランニングコストを低廉化できるとともに、駆動用IC40の耐電特性を低く抑えて駆動用IC40のコストを削減できる。

【0082】また、従来、シェアモード駆動により隔壁を剪断変形させるアクチュエータにおけるインク室内において互いに対向する独立した複数の電極を单一の駆動回路に集約して電圧印加を行う必要があるため、インク室毎に複数の電極を一つに集約してアクチュエータ上面の平坦な実装領域に延長していた。これに対して、上記の製造方法においては、インク室26内に充填された導電性樹脂10又は半田によってインク室26内の複数の電極を一つに集約することができ、しかもチャンネルウェハからのアクチュエータ20の切り出し時に切断された導電性樹脂10又は半田の切断面、又は、上面において露出した平坦部が外部の駆動用IC40との接続部となるため、アクチュエータ20にアクティブ領域以外の実装領域を形成する必要がなく、製造工程を簡略化することができる。

【0083】さらに、アクチュエータ20における外部接続用の電極は、導電性フィラー材料としてAu、Ag、Ni、Cu若しくはカーボンを導電性フィラーとして含有する導電性樹脂10、又は、半田によって構成される。このため、導電性フィラーとしてAu又はAgを用いた場合には、導電性樹脂10の電気抵抗及び駆動用IC40に同通した電極との接続抵抗を低く抑えることができるため、アクチュエータ20の駆動のための印加電圧の波形が鈍ることなく、駆動周波数を向上させて高速印字を実現できる。また、導電性フィラーとしてNi又はCuを用いた場合には、導電性樹脂10のコストを低廉化することができ、アクチュエータ20を安価に提供することができる。さらに、半田を用いた場合には、溶融した半田の金属拡散接合により駆動用IC40

に導通した電極と電気的に接続されるため、接続状態の信頼性を向上させることができるとともに、接続抵抗を低減することができる。

【0084】加えて、アクチュエータ20における外部接続用の電極を構成する導電性樹脂10の導電性フィラーを針状、フレーク状又はコンベイタウ状の角部を有する形状にすることにより、インク室26内の電極27、28がA1等を素材として形成される場合に表面に形成された酸化皮膜を導電性樹脂10の充填工程時に電極27、28の表面に当接する導電性フィラーによって破壊することができる。これによって、導電性樹脂10と電極27、28との接続抵抗を低減させて、アクチュエータ20の駆動のための印加電圧の波形が鈍ることを防止し、駆動周波数を向上させて高速印字を実現できる。

【0085】また、アクチュエータ20における外部接続用の電極を構成する導電性樹脂10の導電性フィラーを略球形の形状とすることにより、導電性樹脂10内における導電性フィラーの密度を最大になり、チャンネルウェハ60からアクチュエータ20を切り出す際に切断された導電性樹脂10の切断面における単位面積当りの導電性フィラーの露出量も最大になる。これによって、導電性樹脂10と駆動用IC40に導通した電極との接続抵抗を低減させて、アクチュエータ20の駆動のための印加電圧の波形が鈍ることを防止し、駆動周波数を向上させて高速印字を実現できる。

【0086】さらに、導電性樹脂10が含有する導電性フィラーの長手寸法がインク室26のインク吐出方向に直交する方向の幅に比較して小さくすることにより、導電性フィラーをインク室26内に確実に充填することができ、インクジェットヘッド1の歩留りを向上することができる。

【0087】なお、保管温度領域及び仕様温度領域でインクジェットヘッド1に十分な信頼性を与えるためには、導電性樹脂10のガラス転移点温度は60°C以上であることが望ましい。

【0088】また、アクチュエータ20における外部接続用の電極を半田によって構成する場合には、最も入手が容易で安価なSn基半田を用いることにより、この発明の実施形態に係る電極接続構造を適用したインクジェットヘッド1を安価に提供することができる。通常、半田は添加元素やその添加量を調整することによって融点を容易に変化させることができるために、インクジェットヘッド1の製造工程における外部電極との接続温度に応じて融点をコントロールし易く、製造工程や仕様の変更に容易に対応することができる。この場合に、保管温度領域及び仕様温度領域でインクジェットヘッド1に十分な信頼性を与えるためには、半田材料の融点は80°C以上であることが望ましい。

【0089】さらに、インク室26内に充填する際の作業性を考慮すれば、導電性樹脂10の硬化前における粘

度は1000～10000cpsとすることが望ましい。また、アウターリード42との接続時における荷重の作用を考慮すれば、導電性樹脂10の硬化後における剪断強度は10gf/mm²以上であることが好ましい。さらに、インク室26内におけるインクの流れを円滑にすることを考慮すれば、インク室26内における導電性樹脂10の前面側が側面断面形状において2次曲線となるように下方において広がっていることが望ましい。

【0090】図3(A)～(C)は、この発明の第2の実施形態に係る電極接続構造を適用したインクジェットヘッドの要部の構成を示すインク吐出方向の背面断面図、平面断面図((A)図におけるX-X部断面図)及び側面断面図((A)図におけるY-Y部断面図)である。この実施形態に係るインクジェットヘッド2は、一例としてポリイミドフィルムを素材とするTABテープ41が有するアウターリード42に形成した突起電極43を、インク吐出方向におけるインク室26の上流側端部に挿入することにより、電極27、28と駆動用IC40との電気的接続を行うようにしたものであり、TABテープ41には駆動用IC40が実装されている。

【0091】この構成において、インク室26内に挿入された突起電極43を介してアクチュエータ20とTABテープ41との機械的な固定を維持することも考えられるが、アクチュエータ20の駆動時や環境変化等による応力が作用した場合を考慮すれば、アクチュエータ20の背面とTABテープ41とを接着剤等を介して別途固定すべきである。

【0092】インク室26内の電極27、28と突起電極43との電気的な接続は、予め個々の突起電極43に導電性接着剤44を塗布しておき、突起電極43をインク室26内に挿入した後に加熱及び加圧して導電性接着剤44を硬化させることにより行う。

【0093】また、突起電極43に導電性接着剤44を転写した導電性接着剤44を硬化させて突起電極43をコア材として導電性樹脂バンプを形成し、導電性バンプを弹性変形させながらインク室26内に挿入することもできる。これによって、導電性樹脂バンプの弹性変形領域内で駆動振動や環境変化による歪を吸収することができ、電極27、28と駆動用IC40との電気的接続状態の信頼性を向上することができる。

【0094】また、突起電極43に代えて、アウターリード42を直接インク室26内に挿入し、公知のシングルポイント接合により、例えば、予めインク室26内の電極27、28の表面に形成したSn膜とアウターリード42の表面に形成したAu膜との間でAu-Sn共晶接続を行うこともできる。この場合、Au-Sn共晶接続に代えてAu-Au固相拡散接合、Au-A1固相拡散接合又は半田接合を用いることもできる。

【0095】インク室26内の電極27、28の材料

は、第1の実施形態に係る電極接続構造と同様に、A1の蒸着膜、Cuの蒸着膜又はNiの蒸着膜等を用いることができる。また、突起電極43を含むアウターリード42の材料は、Au、Cu、Sn、Ni、A1若しくは半田等のリード材料、又は、リードに対するメッキ材料等を用いることができる。インクジェットヘッド2におけるアクチュエータ20、カバーブレート30及びノズルブレート25等のその他の構成、並びに、インクの吐出メカニズムは、第1の実施形態に係る電極接続構造を適用したインクジェットヘッド1と同様である。

【0096】上記の構成により、インクジェットヘッド2においても、駆動用IC40との電気的接続のために電極27、28をアクチュエータ20の側面や上面に延出して形成する必要がなく、アクティブ領域以外の実装領域をアクチュエータ20に形成する必要がなく、アクチュエータ20を構成する圧電素子材料のコストを低廉化することができる。また、アクチュエータ20の質量を削減することによって静電容量を低減することができ、駆動周波数を向上して高速印字を実現することができるとともに、駆動電圧の低減によって駆動用IC40を低耐電圧化することができ、駆動用IC40の部品コスト、及び、ランニングコストの低廉化を実現できる。

【0097】なお、TABテープ41に形成する突起電極43は、通常はAuめっきバンプ、Auワイヤバンプ又はAu転写バンプ等を用いて形成することができる。しかし、より確実な電気的接続状態を得るために突起電極43をアクチュエータ20の隔壁29に当接させながらインク室26内に挿入する場合には、Pt単体、Pt合金、In単体又はIn合金等の塑性変形が容易な材料が適している。また、突起電極43を弹性変形が容易な導電性樹脂バンプで形成することにより、当接時に隔壁29を破損するがないようにして製造時の歩留りを向上することができる。

【0098】また、図4に示すように、アクチュエータ20の背面におけるインク室26の開口部にザグリ等によって凹部26aを形成して開口幅を拡大しておくことにより、インク室26内にアクチュエータ20の背面側から突起電極43を挿入する際のインク室26と突起電極43との位置決めを容易に行うことができる。即ち、インクの吐出方向に直交する方向において突起電極43の幅をインク室26の幅に略一致させた場合、突起電極43をインク室26内に挿入する際に突起電極43とインク室26とを正確に位置決めする必要があるとともに、アクチュエータ20に形成する複数のインク室26の間隔及びそれぞれの幅、並びに、TABテープ41に形成する複数の突起電極43の間隔及びそれぞれの幅を所定の寸法に厳密に規定する必要があり、インクジェットヘッド2の組立作業や各部品の製造作業が煩雑化する。

【0099】そこで、アクチュエータ20の背面におい

て隣接するインク室26が連通しない範囲で各インク室26の周縁部に凹部26aを形成することにより、インク室26と突起電極43との位置決め精度や各部品の寸法精度を緩和することができる。例えば、インク室26及び突起電極43のピッチが20μm、インク室26の幅が70μm、突起電極43の幅が60μmである場合、凹部26aが無い状態でのインク室26に対する突起電極43の位置の許容誤差は±5μmであるのに対して、開口幅90μmの凹部26aを形成した状態では許容誤差が±10μmに拡大する。なお、アクチュエータ20に形成した凹部26aに突起電極43を挿入する場合には、突起電極43と電極27, 28との電気的接続は導電性接着剤を介して行う。

【0100】また、図5に示すように、アクチュエータ20の背面においてインク室26の周縁部にテーパー状の傾斜面26bを形成することによってもインク室26の開口面積を拡大することができ、凹部26aを形成した場合と同様に、インク室26に対する突起電極43の位置決めを容易にすることができる。即ち、インク室26内にアクチュエータ20の背面側から突起電極43を挿入する際に、インクの吐出方向に直交する方向においてインク室26に対する突起電極43の位置に多少の誤差がある場合にも、突起電極43は傾斜面26bに当接することによるセルフアライメント効果によってインク室26内に正確に導かれ、製品歩留りを向上することができる。

【0101】アクチュエータ20の背面におけるインク室26の周縁部に形成した凹部26a又は傾斜面26bはこの発明のガイド部であり、この凹部26a又は傾斜面26bには、インク室26内に形成される電極27, 28を連続して形成することもできる。これによって、インクの吐出方向に直交する方向について突起電極43の幅をインク室26の幅と凹部26aの開口幅との範囲内、又は、対向する2つの傾斜面26bの間隔の最小幅と最大幅との範囲に設定することにより、凹部26aの内側面又は傾斜面26bの中間部分で突起電極43と電極27, 28との電気的接続を確実に行うことができる。また、傾斜面26bを形成した場合には、突起電極43が傾斜面26bに当接した際に塑性変形することにより、突起電極43と電極27, 28との接触面積が拡大し、両者の電気的接続をより確実に行うことができる。

【0102】また、突起電極43を塑性変形が容易なAu、In若しくはPt等の素材、又は、弹性変形が容易な導電性樹脂バンプによって形成することにより、インク室26内への挿入時にインク室26の周縁部との当接によって突起電極43を塑性変形又は弹性変形させることができ。したがって、インクの吐出方向に直交する方向についてインク室26の幅よりも広い部分を突起電極43の少なくとも一部に形成することにより、インク

室26内に形成された電極27, 28と突起電極43との電気的接続を確実に行うことができる。

【0103】以上の構成によれば、TABテープ41のアウターリード42上に形成された突起電極43をインク室26内に挿入することにより、インク室26内の電極27, 28と駆動用IC40との電気的接続を行うようとしているため、インクジェットヘッド2の製造作業時に駆動用IC40をTABテープ41に実装したTABデバイスとして供給することができる。これにより、通常、TABデバイスとしたICではパッドピッチの狭小化が容易であることから、駆動用IC40の小型化及びコストダウンを実現できる。また、TABデバイスとした駆動用IC40をリール・トゥ・リール方式によって搬送することができ、インクジェットヘッド2の生産性が向上する。

【0104】また、突起電極43をインク室26内に挿入する構成であるため、駆動用IC40をペアチップの状態でアクチュエータ20に取り付けることができ、インクジェットヘッド2の小型軽量化を実現できるとともに、使用時にインクを収納するアクチュエータ20に駆動用IC40が接触することによって駆動用IC40に発生した熱をインクを収納したアクチュエータ20に伝導させて放熱効率を向上することができ、駆動用ICを安定して動作させることができる。

【0105】さらに、突起電極43とインク室26内の電極27, 28とを導電性接着剤を介して電気的に接続することにより、インク室26が駆動時に振動を生じた場合やインク室26に熱応力が作用した場合にも導電性接着剤が弹性変形することによってインク室26の歪を吸収することができ、突起電極43と電極27, 28との電気的接続状態の信頼性を向上することができる。また、この場合には、インクの吐出方向に直交する方向について突起電極43の断面積をインク室26の断面積よりも小さくすることができ、インク室26内に挿入される突起電極43の当接によって隔壁29が破損することなく、製品歩留りを向上することができる。

【0106】加えて、突起電極43とインク室26内の電極27, 28との電気的接続に異方導電性接着剤を用いることにより、インク室26内の隔壁29の側面を含むアクチュエータ20の背面に異方導電性接着剤を塗布しておき、電極27, 28と突起電極43との電気的接続、及び、アクチュエータ20と突起電極43を形成したTABテープ41又は駆動用IC40との機械的な固定を同時に行うことができ、製造工程を簡略化することができる。

【0107】また、インク室26内の電極27, 28とTABテープ41に形成された突起電極43との電気的接続に金属拡散接合を用いることにより、電極27, 28と突起電極43との間の接続抵抗を低減することができ、駆動時に印加する電圧波形の鈍りを防止して駆動周

波数の向上による高速印字を実現できる。

【0108】さらに、突起電極43において少なくともインク室26への挿入時にインク室26と当接する部分に塑性変形又は弾性変形が容易な材料を用いることにより、突起電極43が当接することによる隔壁29の破損を防止することができるとともに、電極27、28と突起電極43との電気的接続を確実に行うことができる。

【0109】なお、インクの漏出を防止するため、アクチュエータ20の背面において、インクの吐出方向におけるインク室26の上流側端部は完全に閉塞している必要がある。そこで、インク室26内に突起電極43を挿入した後に、アクチュエータ20とTABテープ41との間に封止用樹脂又はACFを充填するようとしてもよい。

【0110】

【発明の効果】この発明によれば、以下の効果を奏することができる。

【0111】(1) インク吐出方向の全域にわたって同一断面形状に形成したインク室の上流側端部に導電性材料を配置し、この導電性材料を介してインク室内の電極を外部駆動回路に電気的に接続することにより、インク室内の電極を導電性材料を介してインク室内において外部駆動回路に電気的に接続することができ、インク室内の電極をインク室内の電極をインク室外に引き出して構成する必要がないとともに、インク室内にインクの吐出に使用されるアクティブ領域以外の電極の引出しのためのスペースを設ける必要がなく、圧電素子の材料コストを削減することができる。また、基板の静電容量を低減することができ、電極を駆動するために印加される信号の周波数を高くすることができ、高速印字に適応することができる。また、同一の周波数では駆動電圧を低減できるためにランニングコストを低廉化するとともに、外部駆動回路の耐電特性を低く抑えて外部駆動回路のコストを削減できる。

【0112】(2) インク吐出方向におけるインク室の上流側端部を導電性樹脂によって閉塞することにより、導電性樹脂によってインク室のインク吐出方向における上流側端部からのインクの漏出を防止し、インク室内における殆どの範囲がインク吐出のためのアクティブ領域とすることができます。これによって、インク室を構成する圧電素子の材料コストを削減できるとともに基板の静電容量を低減することができ、電極を駆動するために印加される信号の周波数を高くすることができ、高速印字に適応することができる。また、同一の周波数では駆動電圧を低減できるためにランニングコストを低廉化するとともに、外部駆動回路の耐電特性を低く抑えて外部駆動回路のコストを削減できる。

【0113】(3) インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一対の隔壁間を所定材料からなる所定形状の導電性フィラーを含んだ導電性材料によって閉塞

することにより、駆動周波数の向上又はコストの削減のいずれを重視するかに応じて材料を選択するとともに、電極の酸化皮膜の効率的な破壊又は単位体積当たりの接触面積の増加のいずれによって接続抵抗を低減するかに応じて形状を選択した導電性フィラーを含む導電性樹脂を用いて、使用目的に応じた機能を実現する状態でインク室内の電極と外部駆動回路とを接続できる。

【0114】(4) インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一対の隔壁間を半田によって閉塞することにより、電極と外部駆動回路とを電気的に接続する際の接続部分に十分な強度を与えて接続状態の信頼性を向上することができる。

【0115】(5) インク吐出方向におけるインク室の上流側端部において一対の隔壁間を閉塞する導電性材料のインク室から露出した部分に外部駆動回路の接続端子を電気的に接続することにより、インク室が形成されている基板に外部駆動回路の接続端子が直接接触することがなく、電極と外部駆動回路との接続部分が電極に対する駆動電圧の印加による隔壁の変形の影響を受けることがないようにして電極と外部駆動回路とを電気的に接続する際の接続部分に十分な強度を与えて接続状態の信頼性を向上することができる。

【0116】(6) インク吐出方向におけるインク室の上流側端部に外部駆動回路の接続端子を挿入することによってインク室内の電極と外部駆動回路とを電気的に接続することにより、インク室内の電極と外部駆動回路との電気的接続を容易に行うことができる。

【0117】(7) 導電性樹脂が充填されたインク室の上流側端部に外部駆動回路の接続端子を挿入することにより、導電性樹脂と接続端子との接続によってインク室内の電極を外部駆動回路に確実に接続することができる。

【0118】(8) インク吐出方向におけるインク室の上流側端部においてインク室内の電極と外部駆動回路の接続端子とを導電性接着剤を介して電気的に接続することにより、外部駆動回路の接続端子をインク室の隔壁に直接当接することなくインク室の上流側端部に挿入することができ、隔壁を破損することを防止して製品歩留りを向上することができる。また、インク室の上流側端部に対する外部駆動回路の接続端子の挿入時の衝撃を導電性接着剤によって緩衝することができ、振動による歪を防止して電気的な接続状態を安定して維持することができる。

【0119】(9) インク室の上流側端部に外部駆動回路の接続端子を挿入した際に、導電性樹脂との当接によって外部駆動回路の接続端子に変形を生じさせることにより、インク室の上流側端部に外部駆動回路の接続端子を挿入する際の衝撃が接続端子によって緩衝され、隔壁の破損を防止して製品歩留りを向上することができるとともに、振動による歪を防止して電気的な接続状態を安定して維持することができる。

【0120】(10)インク室の上流側端部への挿入時に外部駆動回路の接続端子をガイド部によってインク室を構成する一対の隔壁間に導くことにより、外部駆動回路の接続端子がインク室内に確実に挿入することができる。

【0121】(11)チャンネルウェハ上に、それぞれが互いに独立した電極を有する一対の隔壁に挟まれた溝状を呈するとともに、インク吐出方向における上流側端部が導電性材料によって閉塞され、さらに、上面がカバーブレートで被覆された複数のインク室を所定ピッチで配列したインクジェットヘッドを形成することにより、インク吐出方向においてインク室内の電極と外部駆動回路とを電気的に接続するための領域を不要にして、チャンネルウェハ上における各インクジェットヘッドの面積を削減することができ、圧電素子の材料コストを削減することができる。また、基板の静電容量を低減することができ、電極を駆動するために印加される信号の周波数を高くすることができ、高速印字に適応することができる。また、同一の周波数では駆動電圧を低減できるためにランニングコストを低廉化するとともに、外部駆動回路の耐電特性を低く抑えて外部駆動回路のコストを削減できる。

【0122】(12)光エネルギーによる局所加熱によって溶融した半田ベーストを用いてインク吐出方向におけるインク室の上流側端部を閉塞することにより、インク室のアクティブ領域に過大な熱負荷が作用することによる脱分極を防止することができ、インク吐出性能の低下を防止できる。

【0123】(13)インク吐出方向におけるインク室の上流側端部を導電性材料によって閉塞する間にインク室のアクティブ領域となる部分を強制的に冷却することにより、インク室のアクティブ領域に熱負荷が作用しないようにし、脱分極によるインク吐出性能の低下を確実に防止できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】この発明の第1の実施形態に係る電極接続構造を適用したインクジェットヘッドの要部の構成を示すインク吐出方向の背面断面図、平面断面図及び側面断面図*

*である。

【図2】上記インクジェットヘッドの製造方法の要部を説明する図である。

【図3】この発明の第2の実施形態に係る電極接続構造を適用したインクジェットヘッドの要部の構成を示すインク吐出方向の背面断面図、平面断面図及び側面断面図である。

【図4】この発明の第2の実施形態に係る別の電極接続構造を適用したインクジェットヘッドの要部の構成を示す平面断面図である。

【図5】この発明の第2の実施形態に係るさらに別の電極接続構造を適用したインクジェットヘッドの要部の構成を示す平面断面図である。

【図6】従来のインクジェットヘッドの電極接続構造の第1の例を示す側面断面図である。

【図7】従来のインクジェットヘッドの電極接続構造の第2の例を示す側面断面図である。

【図8】従来のインクジェットヘッドの電極接続構造の第3の例を示す側面断面図である。

【図9】従来のインクジェットヘッドの製造方法の要部を示す斜視図である。

【図10】従来のインクジェットヘッドの電極接続構造の第4の例を示す側面断面図である。

【符号の説明】

1. 2 - インクジェットヘッド

10 - 導電性樹脂

20 - アクチュエータ

24 - ノズル孔

25 - ノズルプレート

30 - インク室

27, 28 - 電極

29 - 隔壁

30 - カバーブレート

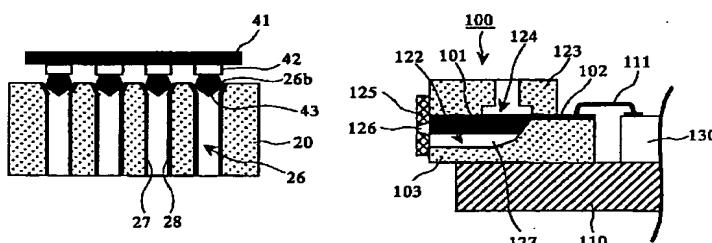
31 - インク供給部

40 - 駆動用 I C (外部駆動回路)

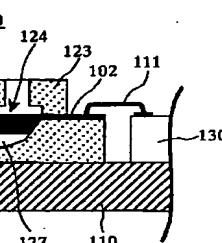
41 - TABテープ

42 - アウターリード

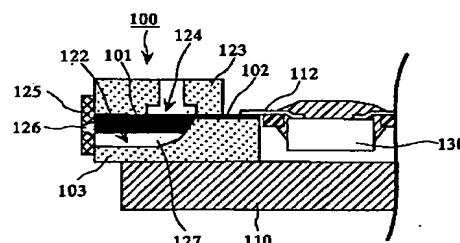
【図5】



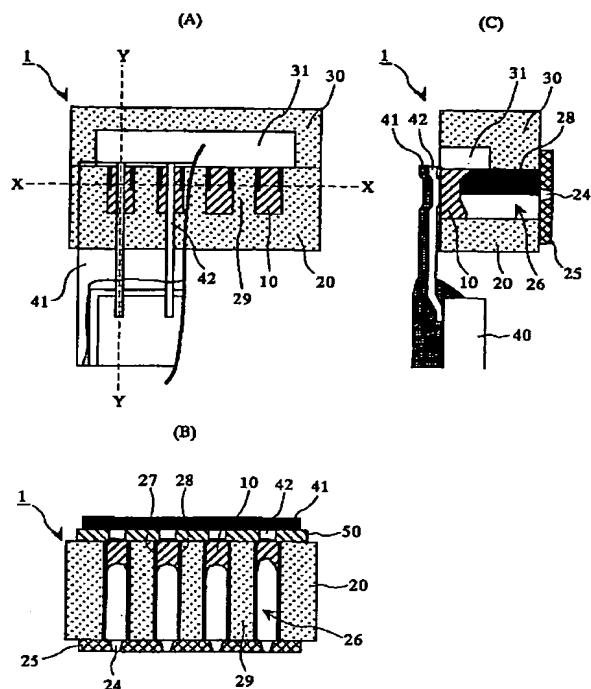
【図6】



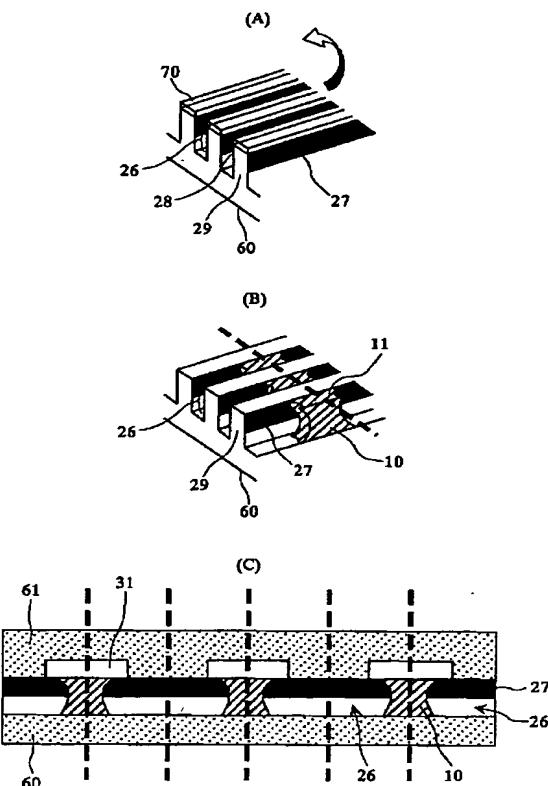
【図7】



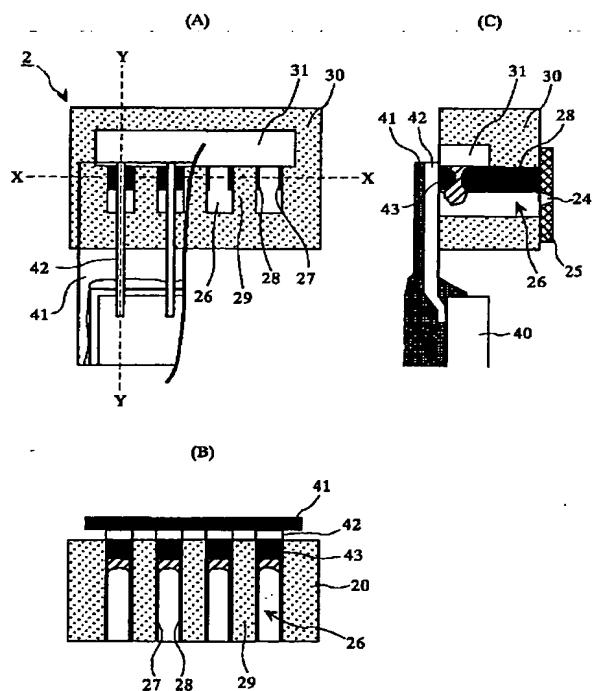
【図1】



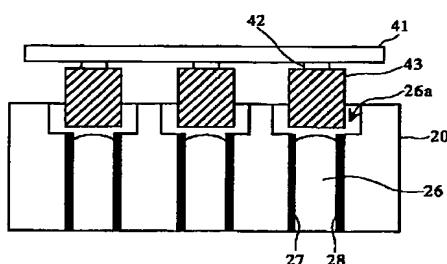
【図2】



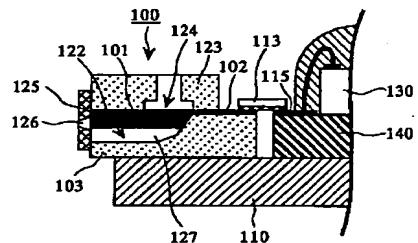
【図3】



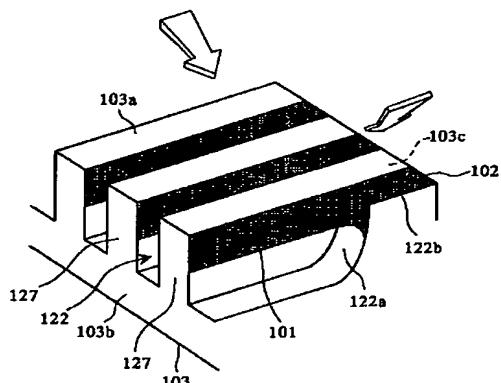
【図4】



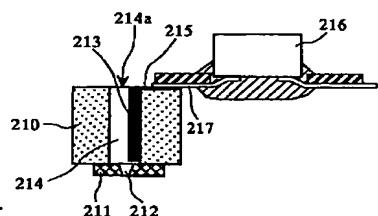
【図8】



【図9】



【図10】



フロントページの続き

(72)発明者 堀脇 成光
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内
(72)発明者 磯野 仁志
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内

(72)発明者 中島 吉紀
大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シ
ヤープ株式会社内
F ターム(参考) 2C057 AF93 AG45 AG89 AP02 AP25
BA03 BA10 BA14